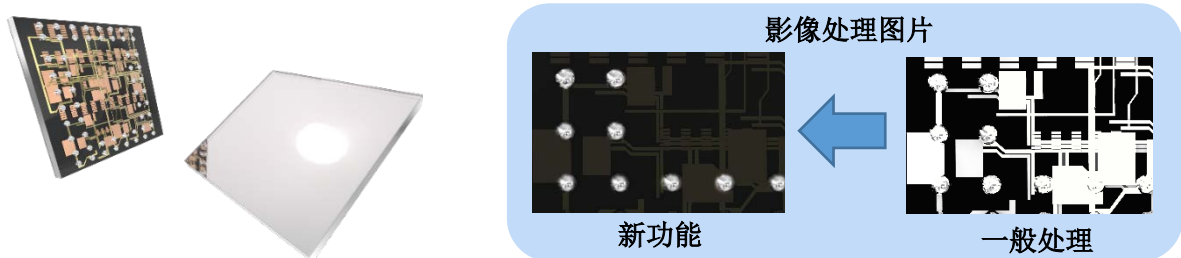


面向生产小型化、高性能化模块元件厂商的 FUJI 贴装解决方案

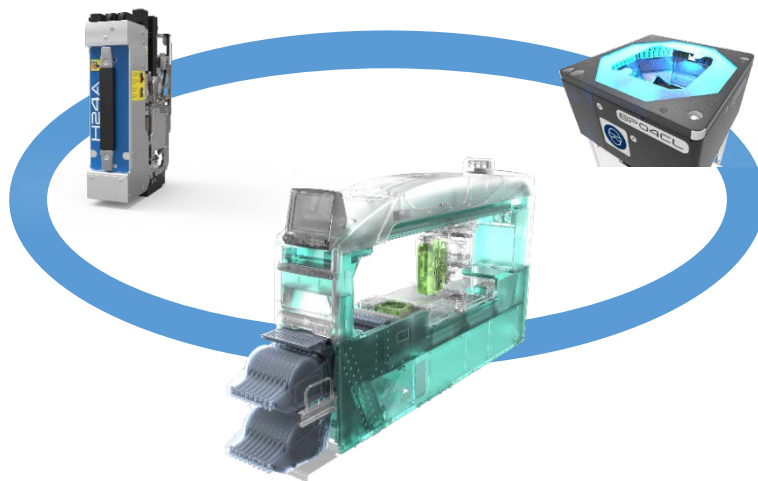
株式会社 FUJI（公司总部：爱知县知立市、董事长兼总经理：曾我信之）通过下文为大家介绍将在今年春季发布的新功能。

伴随着移动设备以及穿戴式设备的普及，对生产这些设备所用到的电子模块元件需求量也在日益增长。与此同时，随着模块元件的小型化、轻量化、高性能化的提高，组成模块元件的基础元件也逐渐小型、高性能化。

在生产现场要面临并必须解决的问题就是如何对应新型元件以及如何有效地生产。例如在贴装 SiP 封装(系统级封装)或 WLCSP(晶圆片级芯片规模封装)等元件时，存在无法在影像处理中准确测出锡球位置的问题。



FUJI 通过提升影像处理相机的功能，成功研发出从 SiP 或 WLCSP 等元件电路中只拍摄锡球的技术。此外，通过向用户提供适合生产模块元件的单元与功能并有效搭配使用(比如，用于贴装的模组 M3IIS、工作头 H24A、附带缺口的特殊吸嘴、真空支撑功能等)，可实现模块元件的高质量贴装，进而提高生产率。



产品详细内容请咨询相关销售部门。